

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2023-039

## 气派科技股份有限公司

### 关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“公司”）就前次募集资金存放与使用情况专项报告如下：

#### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1714号）核准，公司2021年6月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26,570,000股，发行价为14.82元/股，募集资金总额为人民币393,767,400.00元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币55,542,826.15元，实际募集资金净额为人民币338,224,573.85元。

该次募集资金到账时间为2021年6月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月17日出具天职业字[2021]33490号验资报告。

##### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年3月31日止，本公司前次募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	募集资金初始存放金额	截至 2023 年 3 月 31 日止余额
中国银行股份有限公司东莞石排支行	669174492837	-	13,761,985.86
上海银行股份有限公司深圳科技园支行	3004561359	-	10,323.88
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100604262	-	409,480.62
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100604014	338,224,573.85	395,358.18
<b>合计</b>		<b>338,224,573.85</b>	<b>14,577,148.54</b>

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表说明

#### 1、前次募集资金实际使用情况

截止 2023 年 3 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 328,080,096.39 元，其中：2021 年度使用 193,589,763.11 元，2022 年度使用 111,448,677.44 元，2023 年 1-3 月使用 23,041,655.84 元，均投入募集资金项目。

截止 2023 年 3 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 328,080,096.39 元，募集资金专户余额为人民币 14,577,148.54 元，与实际募集资金净额人民币 338,224,573.85 元的差异金额为人民币 4,432,671.08 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

#### 2、前次募集资金投资项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异说明

截至 2023 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目的实际投资金额和募集后承诺投资金额的差异列示如下：

单位：人民币元

序号	投资项目	募集后承诺投资金额	实际投入募集资金金额	差异金额
1	高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	318,224,573.85	321,233,340.34	-3,008,766.49
2	研发中心（扩建）建设项目	20,000,000.00	6,846,756.05	13,153,243.95

序号	投资项目	募集后承诺投资金额	实际投入募集资金金额	差异金额
	合计	338,224,573.85	328,080,096.39	10,144,477.46

高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目实际投入募集资金金额大于募集后承诺投资金额 3,008,766.49 元，主要原因系理财收益及利息收入扣除手续费后的净收益增加募集资金，补充投入该项目。研发中心（扩建）建设项目投资差异主要原因系项目尚在建设期，尚有部分募集资金未投入使用。

#### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

#### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

#### （四）闲置募集资金使用情况说明

2021 年 7 月 6 日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用额度不超过 2,000.00 万元的募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。

#### （五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金尚未使用的金额为 14,577,148.54

元，尚未使用金额占前次募集资金净额的比例为 4.31%，将继续用于前次募集资金投资项目。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告“附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。

#### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不适用前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

#### （四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

### 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2021 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

### 五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

气派科技股份有限公司董事会

2023年6月21日

附表 1:

## 气派科技股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 3 月 31 日

编制单位：气派科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：338,224,573.85						已累计使用募集资金总额：328,080,096.39				
募集资金净额：338,224,573.85						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：不适用						2021年度使用193,589,763.11				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2022年度使用111,448,677.44				
						2023年1-3月使用23,041,655.84				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	437,167,647.56	318,224,573.85	321,233,340.34	437,167,647.56	318,224,573.85	321,233,340.34	-3,008,766.49	2024 年 6 月
2	研发中心（扩建）建设项目	研发中心（扩建）建设项目	48,761,684.50	20,000,000.00	6,846,756.05	48,761,684.50	20,000,000.00	6,846,756.05	13,153,243.95	2023 年 6 月
合计			485,929,332.06	338,224,573.85	328,080,096.39	485,929,332.06	338,224,573.85	328,080,096.39	10,144,477.46	

附件 2

## 气派科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2023 年 3 月 31 日

编制单位：气派科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月		
1	高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	81.27%	不适用	19,603,082.02	-9,679,561.52	-8,466,948.64	1,456,571.86	不适用
2	研发中心（扩建）建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：公司在 2021 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出承诺。

注 2：公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。